

Kompakter Hybrid-Reflow-Ofen 50-250 °C für Reballing und QFN-Prebumping - Martin MINIOVEN 05

Artikel-Nr. MAR-HB00.0025

Hersteller Martin

Kompaktes Tischgerät zum Reballen von BGA-Bauteilen und Prebumpen von QFN-Chips. Die Hybridheiztechnik erwärmt von allen Seiten gleichmässig für reproduzierbare Ergebnisse, mit 550 VA Leistung und 25 Profilspeicherplätzen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.8 kg
Leistung	550
Temperaturbereich	50-250 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85152900000



BESCHREIBUNG

Der MINIOVEN 05 von Martin ist ein kompaktes, robustes Tischgerät für das Reballen von BGA-Bauteilen und das Prebumpen von QFN-Chips. Die Hybridheiztechnologie erwärmt die elektronischen Bauteile von allen Seiten gleichmässig und liefert so reproduzierbare Reballing-Ergebnisse in Entwicklung und Produktion.

VORTEILE

- Gleichmässige Hybridheizung mit 500 W Unterheizung (4 x IR-Lampen) für wiederholbare Reflow-Profile
- Bis zu 25 Heizprofile über die intuitive Menüführung anlegen, verwalten und speichern
- Zusätzlicher externer Temperatursensor für zuverlässiges automatisches Anlernen der Profile
- PC-Software EASYBEAM zum komfortablen Editieren der Profile und Darstellen des Temperaturverlaufs
- Prozessgas-Anschluss für Reflow unter Stickstoffatmosphäre

ANWENDUNGEN

- Reballen von BGA-Bauteilen in Reparatur, Entwicklung und Produktion
- Prebumpen von QFN-Bausteinen mit verfügbaren Bauteilaufnahmen und Vorrichtungen
- Reflow-Prozesse unter Stickstoff über den Prozessgas-Anschluss

LIEFERUMFANG

Basisgerät inklusive Grundausstattung mit externem Temperatursensor (K-Typ), Cuttermesser, SMD-Haken, Reinigungsstift mit drei Ersatzeinsätzen, Kaptonband, Lupe, Netzkabel und Handbuch.